

DA 158N 固晶黏著劑 产品数据表

卓越的熱循環性能

優異的機械衝擊性能

高良率

简介

DA 158N 是一種電絕緣導熱型固晶黏著劑。它可在較低溫度下固化。該材料專為極其嚴苛的晶片黏接應用而設計，也適用於各種先進封裝（例如記憶卡、晶片載體、混合電路和多晶片模組）中的裸晶片保護。它專為高產量和環保生產環境而設計，尤其適用於對製程速度和機械衝擊有較高要求的應用。該材料易於點膠，可最大限度地減少應力，並提供卓越的可靠性性能（例如溫度循環性能）和出色的機械強度。

物理特性

产品名称	DA 158N 固晶黏著劑
外觀	無色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.8 g/cc
黏度(Brookfield, 0.5 rpm)	5-8.0k cp
固化材料特性	
玻璃化转变温度 Tg	138 /°C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	1 = 22; 2 = 71
导热系数 (W/mK)	2-3
剪切强度	2,600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过

推荐固化条件

在 150°C 下加热 40-60 分钟。根据客户要求，可提供其他固化方案。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下，如材料保持于密封的原始容器中，保质期为 6 个月。超过该存储期限，材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染，否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全

DA 158N 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中，仍建议遵循基本的工业卫生规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装

DA 158N 毛细管封装系列产品提供 10 cc 和 30 cc 两种规格。其他包装规格可依客户需求客制化。如需订购信息，请联系 YINCAE 公司。